

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2015年 7 月24日
【会社名】	株式会社日立ハイテクノロジーズ
【英訳名】	Hitachi High-Technologies Corporation
【代表者の役職氏名】	代表執行役 執行役社長 宮 崎 正 啓
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋一丁目24番14号
【電話番号】	東京(03)3504-7111
【事務連絡者氏名】	経理部長 橋 本 成 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋一丁目24番14号
【電話番号】	東京(03)3504-7111
【事務連絡者氏名】	経理部長 橋 本 成 浩
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2015年7月24日の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社日立ハイテクインスツルメンツに対する債権放棄を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき、臨時報告書を関東財務局長に提出するものであります。

2【報告内容】

(1)当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名および資本金の額

名称	株式会社日立ハイテクインスツルメンツ
住所	埼玉県熊谷市妻沼西一丁目6番地
代表者の氏名	代表取締役 取締役社長 木村 勝高
資本金の額	450百万円

(2)当該債務者等に生じた事実およびその事実が生じた年月日

株式会社日立ハイテクインスツルメンツは、2015年3月末までにチップマウンタ事業からの撤退および半導体後工程装置事業(ボンディング装置事業)の譲渡を実施した結果、現在実質的な事業運営を休止している状態にあります。

この度、これまでに同社がお客様にお納めしたチップマウンタ事業に係る製品の納入者としての責任を引き続き全うするとともに、グループ経営の効率化を図るため、同社を吸収合併することといたしました。

その手続きの一環として、2015年7月24日開催の取締役会において、同社に対する債権を放棄することを決議いたしました。なお、当該債権放棄の実施は2015年9月を予定しております。

(3)当該債務者等に対する債権の種類および金額

貸付金 約115億円(見込み)

(4)当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響

当該債権につきましては、貸倒引当金を計上しており、債権放棄による当社の業績に与える影響は軽微であります。